

SEM・表面分析・前処理セミナー@大阪

プログラム

09: 30～	受付	
10: 00～10: 10	開会挨拶	
10: 10～10: 40	IoTクロスセクションポリッシャ™の新機能の紹介 ～高速・冷却・非曝露加工で進化する試料作製～	日本電子株式会社 SI事業部門 EP事業ユニット EPアプリケーション部 應本 玉恵
10: 40～11: 10	～SEMの測定作業を効率化～ 進化した自動観察・分析機能 Neo Action のご紹介	日本電子株式会社 SI事業部門 EP事業ユニット EPアプリケーション部 高山 隼
11: 10～11: 40	高自由度・高安全性を備えた FIB-SEM JIB-PS500iの応用例紹介	日本電子株式会社 SI事業部門 EP事業ユニット EPアプリケーション部 中島 雄平
11: 40～12: 15	昼食	
12: 15～13: 00	実機・ポスター展示	
13: 00～13: 30	WDSスペクトラマップ分析の紹介	日本電子株式会社 SI事業部門 SA事業ユニット SA技術開発部 縄舩 泰輝 /加藤 光樹
13: 30～14: 00	現場で使える EPMAテクニック	日本電子株式会社 ソリューション開発センター ソリューション推進部 土門 武
14: 00～14: 30	Augerを用いたスペクトルの取得について	日本電子株式会社 SI事業部門 SA事業ユニット SA技術開発部 伊木田 木の実
14: 30～15: 00	XPSを用いた粉体分析を行う方へ ～各種試料固定方法のコツ紹介～	日本電子株式会社 SI事業部門 SA事業ユニット SA技術開発部 村谷 直紀
15: 00～15: 50	休憩 /実機・ポスター展示	
15: 50～16: 20	これから始める Volume EM ～電子顕微鏡を用いた 3次元構造解析の紹介～	日本電子株式会社 ソリューション開発センター ソリューション企画室 鈴木 克之
16: 20～16: 50	SEM観察基礎編 ～反射電子を使いこなす～	日本電子株式会社 ソリューション開発センター ソリューション推進部 八幡 英里香
16: 50～17: 00	閉会挨拶	
17: 00～18: 10	懇親会 /実機・ポスター展示	

*プログラムは予告無く変更させていただく場合がございます。予めご了承頂きますようお願い申し上げます。